

2017年9月21日

---

## 半導体製造装置用部品（ESC）製造設備増設工事竣工のお知らせ

---

住友大阪セメント株式会社（社長：関根福一、本社：東京都千代田区）は、市川事業所（千葉県市川市）において、半導体製造装置の主要部品であるESC（静電チャック※）の製造設備増設工事を2017年9月20日に竣工しましたのでお知らせ致します。

スマートフォンやタブレット等の携帯端末を利用した動画配信や企業がセキュリティ向上の為に利用するデータセンターの普及などによりインターネット通信量の増大が見込まれるなか、半導体市場はメモリ、ロジックともに継続した成長が予想されており、同様に半導体製造装置の需要も継続的な拡大が見込まれています。

当社の新材料事業の主力製品であるESC（静電チャック）は、超高純度のSiC超微粒子を原料とした高純度、高熱伝導、高耐電圧、高耐久性の特性を持ち、半導体製造装置の主要部品として数多く採用されています。今般の設備増設により、増大する半導体製造装置需要に対応し、顧客のニーズを掴み、ニーズにあった製品をタイムリーに生産出荷することで、事業の拡大を図るとともに、高効率生産ラインを構築し、安定品質とコスト削減をおこない競争力を強化して参ります。

※ ESC（静電チャック）は、半導体製造工程において静電気力を用いてシリコンウェハを固定する部品で半導体製造装置の主要部品として使用されます。





【 新生産ラインのある新設備棟 】

【本件に関する問い合わせ先】

総務部 IR 広報グループ TEL 03-5211-4505 FAX 03-3221-4651

以上